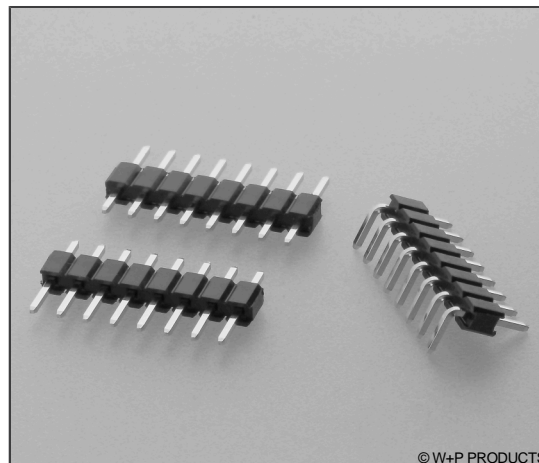
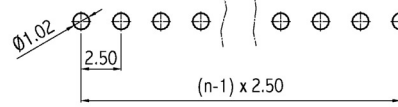
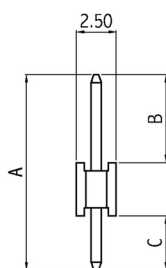
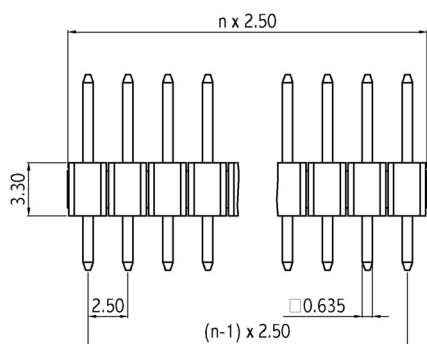


Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0, schwarz <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0, black</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Vierkantstift 0,635mm, Kupferlegierung <i>0.635mm square pin, copper alloy</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni <i>Acc. to options (see below), over Ni</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500 V AC
Nennstrom <i>Current Rating</i>	3 A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40 °C ... +105 °C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren <i>Wave or reflow soldering</i>

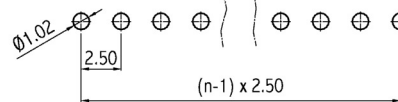
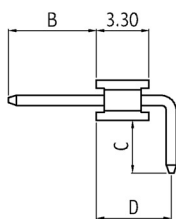
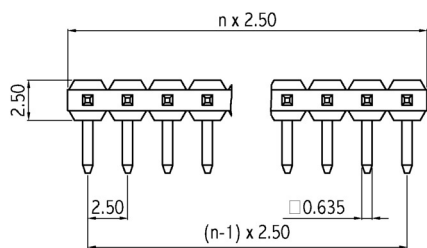


© W+P PRODUCTS



PCB Layout

Series	Dimensions*	Contacts*	Type	Plating*
243	13 12 A=11,30 B=4,70 C=3,30mm 13 A=12,60 B=6,00 C=3,30mm 14 A=13,90 B=7,30 C=3,30mm A- Weitere Abmessungen möglich More dimensions available	04 01-40	1 1 Gerade Straight	50 00 Vergoldet Gold plated 50 Verzinnt Tin plated 60 Sel. Au/Sn Duplex plating



PCB Layout

Series	Dimensions*	Contacts*	Type	Plating*
243	13 12 B=3,50 C=3,30 D=4,70mm 13 B=4,80 C=3,30 D=4,70mm 14 B=6,10 C=3,30 D=4,70mm 16 B=9,90 C=3,30 D=4,70mm 99- Weitere Abmessungen möglich More dimensions available	08 01-40	2 2 Gewinkelt Right-angled	50 00 Vergoldet Gold plated 50 Verzinnt Tin plated 60 Sel. Au/Sn Duplex plating

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** - please replace by your specifications.

Informationen zum Wellen-Lötverfahren

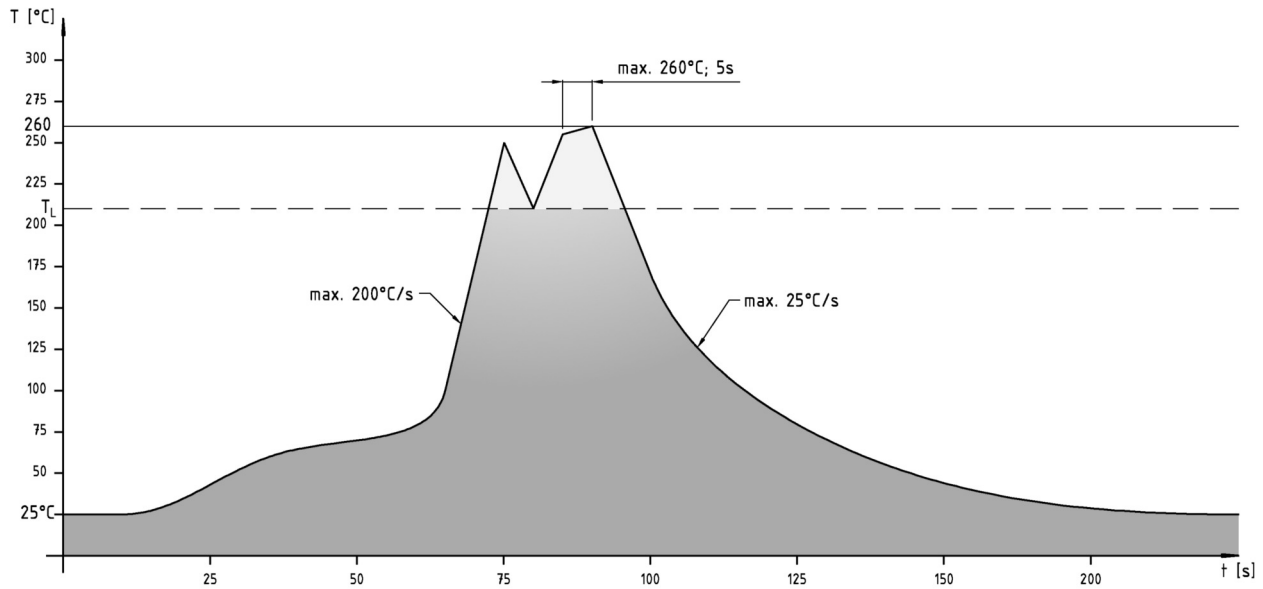
Wave Soldering Information

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.

Empfohlenes Wellenlötprofil:



Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150 °C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150 °C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature T_L	217 °C
Duration above T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature T_P	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	max. 8min

